





Integr8tor v2020.12



Release Überblick

Ihr Wettbewerbsvorteil ...

- QED Analyse für Backdrilled PCB's 
- Altium PCB Input Connector 
- DPMX (IPC-2581) Daten Input 
- QED Conditional Formatting auf Grundlage von Kupferstärken 
- Und mehr!

QED Analyse für Backdrilled PCB's

- **Vollautomatisches** Einlesen von Produkten mit Backdrilling
- Umfassende Backdrill-spezifische QED **Analyse**

(Neue Option)

| INITIAL | FORMAT | RENAMED | FUNCTION |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 7770_Non_Switch_081015-bd-1-4.drl | excellon2 | drl_1_4 | backdrill |
| 7770_Non_Switch_081015-bd-1-6.drl | excellon2 | drl_1_6 | backdrill |
| 7770_Non_Switch_081015-bd-1-8.drl | excellon2 | drl_1_8 | backdrill |
| 7770_Non_Switch_081015-bd-24-10.drl | excellon2 | drl_10_24 | backdrill |
| 7770_Non_Switch_081015-bd-24-12.drl | excellon2 | drl_12_24 | backdrill |
| 7770_Non_Switch_081015-bd-24-15.drl | excellon2 | drl_15_24 | backdrill |
| 7770_Non_Switch_081015-bd-24-17.drl | excellon2 | drl_17_24 | backdrill |
| 7770_Non_Switch_081015-bd-24-19.drl | excellon2 | drl_19_24 | backdrill |
| 7770_Non_Switch_081015-bd-24-21.drl | excellon2 | drl_21_24 | backdrill |
| 7770_Non_Switch_081015-bd-24-7.drl | excellon2 | drl_7_24 | backdrill |
| 7770_Non_Switch_081015-bd-24-8.drl | excellon2 | drl_8_24 | backdrill |

Altium PCB Input Connector

- Altium Designer software wurde integriert um .pcbdoc Dateien von Altium vollautomatisch einzulesen
- Seien Sie **der Erste**, der ein Angebot liefert!

(Neue Option)



DPMX (IPC-2581) Daten Input

- Lesen Sie die Daten im neuen Standard-DPMX-Format vollautomatisch ein
- **Steigern Sie Ihren Marktanteil**, indem Sie das bevorzugte Format eines Kunden akzeptieren

(Neue Option)



Kupferstärke als Grundlage

- Die rot hervorgehobenen Felder in Ihrem QED PDF Report sagen Ihnen **viel mehr**, wenn Sie die Abstände und Kupferbreiten mit den Kupferstärken in Beziehung setzen ...

(Ergänzung zum *existierenden QED PDF Report*)

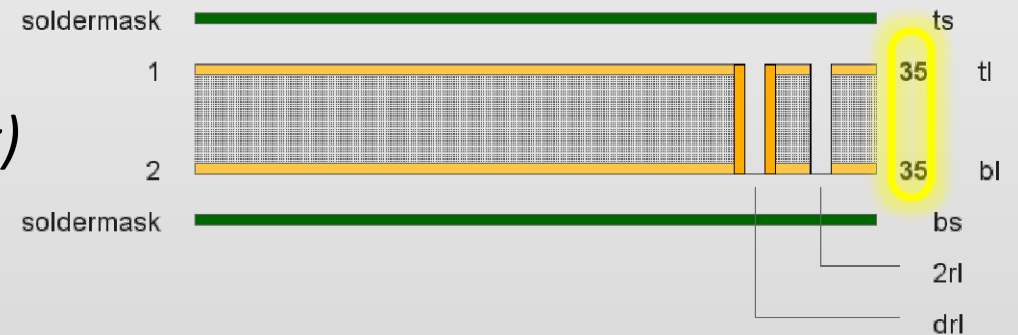
```
61 Example:
62 <FormattingRule id="minimumtrack">
63   <Condition>lessthan</Condition>
64   <Value1>0.075</Value1>
65   <ThicknessRule id="base">
66     <Condition>lessthan</Condition>
67     <Value1>0.035</Value1>
68   </ThicknessRule>
69 </FormattingRule>
70 <FormattingRule id="minimumtrack">
71   <Condition>lessthan</Condition>
72   <Value1>0.1</Value1>
73   <ThicknessRule id="base">
74     <Condition>between</Condition>
75     <Value1>0.035</Value1>
76     <Value2>0.070</Value1>
77   </ThicknessRule>
78 </FormattingRule>
79 <FormattingRule id="minimumtrack">
80   <Condition>lessthan</Condition>
81   <Value1>0.125</Value1>
82   <ThicknessRule id="base">
83     <Condition>greaterthan</Condition>
84     <Value1>0.070</Value1>
85   </ThicknessRule>
86 </FormattingRule>
87 -->
```

| Critical Trace Width | Copper to Copper Clr. |
|----------------------|-----------------------|
| mm | mm |
| >0.40 | ³ 0.23 |

End- und Basiskupferstärke je Lage im QED

- Definieren Sie beispielsweise die Kupferstärke - zusammen mit anderen Produktparametern - in einer gbrjob-Datei, fügen Sie diese dem Archiv hinzu und senden Sie sie an Integr8tor
- Einfach, leicht und clever ...

(Ergänzung zum *existierenden QED PDF Report*)



| Files - Original | | | | | | |
|------------------|---------|----------|----------|-------|-----------|----------|
| Initial | Renamed | Function | Position | Color | Thickness | |
| | | | | | Base | Finished |
| | | | | | | |

Erfassung der interaktiven Zeit für einen Job

- Finden Sie heraus, wie viel Zeit Ihre Mitarbeiter interaktiv während einer «To Ucam»-Sitzung auf Jobs verwenden müssen
- Identifizieren Sie Kunden deren Datensätze systematisch manuelle Eingriffe erfordern. **Beginnen Sie das Gespräch** die Daten auf aktuelle Standards zu bringen

(Ergänzung zum *existierenden Cockpit*)

| Original Data | Interactive Time |
|------------------------------|------------------|
| CDIpinv1.40vp (ID 18941).zip | 01:21 |
| 107665.zip | 00:00 |
| 107470.zip | 00:00 |
| 107154.zip | 00:00 |
| 107084.zip | |
| 106488.zip | 01:17 |
| 106046.zip | 00:00 |
| 105847.zip | 00:00 |
| 105832.zip | 00:00 |

Auto Log-Off

- Lassen Sie inaktive oder vergessene Cockpit-Sitzungen, beispielsweise nach einem Netzwerk- oder VPN-Ausfall, automatisch beenden
- **Vermeiden Sie, dass Ihnen die Cockpit-Lizenzen ausgehen** weil Benutzer vergessen haben, sich abzumelden

(Ergänzung zum *existierenden Cockpit*)

Auto log-off

Automatic log-off after

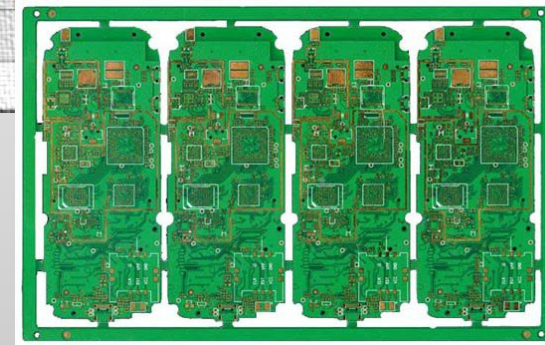
minutes

Analyse der Frässtrecke

- Fräsen von Bestückungsnutzen beeinflusst die Kosten und Lieferzeit erheblich
- Die neue Frässtrecke im QED hilft, dies zu antizipieren

(Ergänzung zur *existierenden Auto Analysis und QED PDF Report*)

| Customer Panel (Delivery Array, Shipping Panel) - Original | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------|--------------|------------|---------------|-----------|-----------|-------|---------------------|
| Original Image | Panel Size | Left Border | Right Border | Top Border | Bottom Border | X Spacing | Y Spacing | PCB's | Depanel Rout Length |
| | mm x mm | mm | | | | mm | mm | | mm |
| Single PCB | 178.021 x 143.000 | 15.000 | | | | 000 | 3.000 | 3 x 2 | 1914.126 |



Zusätzliche Oberflächenveredelungen und Lötstopmaskenfarben

- Zusätzliche Lötstopmaskenfarben und Oberflächenveredelungen zur Unterstützung Ihrer hochmodernen Produktion

(Ergänzung zum *existierenden Cockpit, der Email Input Integration, der Web Input Integration, der Hotfolder Input Integration*)

Erweiterung der QED Lötmaskenanalyse

- Eine präzise Analyse um unterschiedliche Öffnungen der Lötstopmasken auf Ober- und Unterseite zu ermitteln und damit **Überraschungen in der Produktion zu vermeiden**

(Ergänzung zur *existierenden Auto Analyse und dem QED PDF Report*)

QED PDF mit Erläuterungen

- Mit den Tooltips in unserem neu gestalteten QED PDF finden sich neue Nutzer in kürzester Zeit zurecht...

| Partly Covered Via Holes | One Side Covered Vias ⓘ | Both Sides Covered Vias ⓘ | No Side Covered Vias ⓘ |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|
| No | | | |

Through-hole vias that are either (partially) covered by soldermask on the top layer and (partially) free on the bottom layer or (partially) free on the top layer and (partially) covered on the bottom layer.

(Ergänzung zum existierenden QED PDF Report)

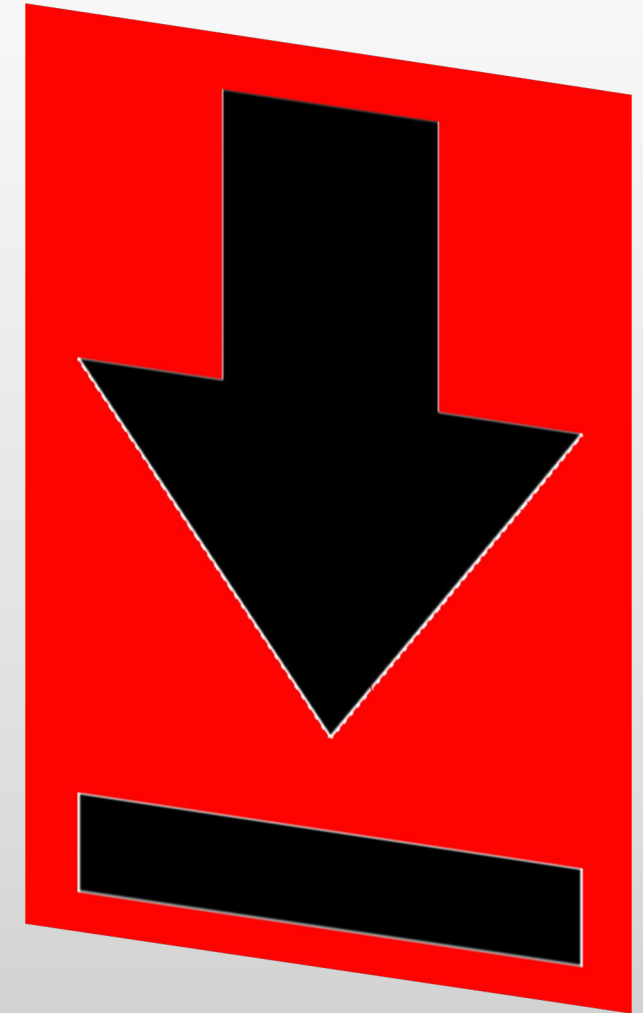
QED PDF Überarbeitung der Zusammenfassung

- Die Zusammenfassung aller wichtigen Eckdaten wurde überarbeitet, so dass die Übersicht noch einfacher und komfortabler ist.

| Summary - General - Original | | | |
|------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| PCB Size | 95 mm x 103.5 mm | Customer Panel Size | |
| PCB Thickness | 1.6 mm | Max. Aspect Ratio on PTH | 8.0 |
| Copper Layers | 6 | Pressing Stages | 1 |
| Surface Finish | unknown | Drill Hole Density | 2101 Holes/dm ² |
| Solder Mask | Both | Testable Points | 1508 |
| Solder Mask Color | unknown | Min. SMD/BGA Size | 0.28 mm |
| Legend | No | Via in Pad | No |
| Legend Color | | Stacked Vias | No |
| Edge Connector Area | 0 dm ² | Castellated | No |
| Peeloff Mask | No | Anomalies | No |
| Carbon Mask | No | | |

(Ergänzung zum existierenden QED PDF Report)

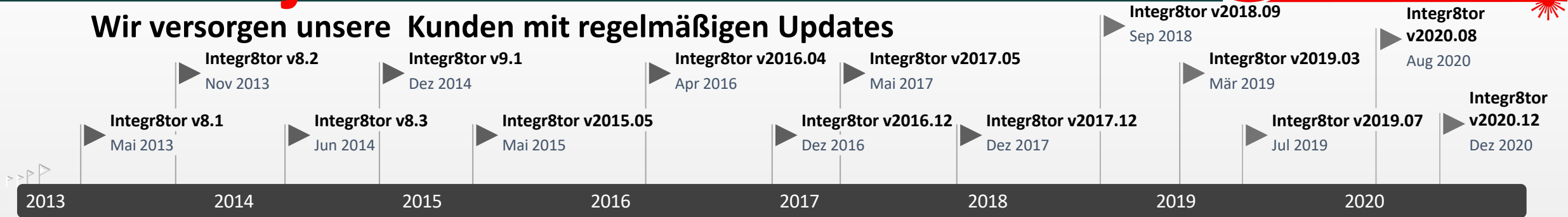
- Das Installationsprogramm kann vom Ucamco FTP-Downloadserver heruntergeladen werden.
<ftp://ftp.ucamco.com/Integr8tor>
- Wir empfehlen, dieses Update so bald wie möglich zu installieren
- Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unseren lokalen Geschäftspartner oder an den Ucamco-Helpdesk
- Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein Ucamco-Produkt entschieden haben



Schon jetzt nach vorne schauen



Wir versorgen unsere Kunden mit regelmäßigen Updates



| Version | Release date | Highlights | |
|---------|--------------|--|--|
| 8.1 | Mai-13 | Unterstützung für ODB++ v7 | Kompatibel mit Windows Server 2012 und Windows 8 |
| 8.2 | Nov-13 | Erkennung und Kennzeichnung von doppelten Archiven | Edge Connector-Erkennung |
| 8.3 | Jun-14 | Neue Standardparameter | Bestimmung von Laser-/mechanischen Bohrungen |
| 9.1 | Dez-14 | Unterstützung für Gerber X2-Datensätze | Optimierte und neue QED-Werte |
| 2015.05 | Jun-15 | Neue Standardparameter | Bestimmung von Laser-/mechanischen Bohrungen |
| 2016.04 | Apr-16 | SMD/BGA Pads unterscheiden Kupfer- und Lötstoppsmasken-definiert | DFM-Checks (ehemals „Capabilities“) überarbeitet |
| 2016.12 | Dez-16 | Vorstellung der Integr8tor Job-Perspektiven | Bohrlochtoleranzen |
| 2017.05 | Mai-17 | Unterstützung von PCB-Oberflächenbehandlungen | Erkennung von Aufträgen gleicher Größe |
| 2017.12 | Dez-17 | Checkpoint-Review-Erweiterungen für verschiedene QED-Ergebnisse | Analyse von Durchsteigebohrungen mit verschiedenen Lötstoppsmaskenöffnungen oben/unten |
| 2018.09 | Sep-18 | Neue QED-Funktion: Kritische Mindestleiterbahnbreite | Benutzerdefinierbare Lagenregistrierung |
| 2019.03 | Mär-19 | Messfunktion und frei darstellbare Layer in Checkpoint | Verbesserte Import/Export Unterstützung für ODB++ Eigenschaften |
| 2019.07 | Jul-19 | Vorstellung von C8Inspect... | QED Restrung-Analyse je Werkzeug-Funktion |
| 2020.08 | Aug-20 | UcamX Workflow Edition | Must-have QED und AutoClean Erweiterungen |
| 2020.12 | Dez-20 | QED Backdrill Analyse | Altium PCB Input Connector |

© Copyright 2021 Ucamco NV, Gent, Belgium. All rights reserved.

This material, information and instructions for use contained herein are the property of Ucamco NV. The material, information and instructions are provided on an AS IS basis without warranty of any kind.

Ucamco NV does not warrant, guarantee or make any representations regarding the use, or the results of the use of the software or the information contained herein.

Ucamco NV shall not be liable for any direct, indirect, consequential or incidental damages arising out of the use or inability to use the software or the information contained herein.

The information contained herein is subject to change without prior notice.

Revisions may be issued from time to time to advise of such changes and/or additions.

No part of this presentation may be reproduced, stored in a data base or retrieval system, or published, in any form or in any way, electronically, mechanically, by print, photoprint, microfilm or any other means without prior written permission from Ucamco NV.